WPI ======

- TI Non-aq. solder paste with improved handling comprises poly:isobutylene and/or polybutene methane-type hydrocarbon(s) and/or fatty acids etc.
- AB J02268995 Non-aq. solder paste comprises (by wt.) 3-96% polyisobutylene and/or polybutene; 4-40% of at least one of methane-type hydrocarbons and fatty acids having a m.pt. of 30 deg.C or higher; and 0-94% of at least one solvent selected from aliphatic hydrocarbons and aromatic hydrocarbons having a m.pt. of 0 deg.C or lower.
 - USE/ADVANTAGE Provides a solder paste of improved handling properties and which is free from residual carbon upon soldering in air, neutral atmos., or in reducing atmos..
 - In an example, a binder comprising (by wt.) 30% of polyisobutylene withpolybutene, 35% of myristic acid, and 35% xylene gave a solder paste having favourable properties. (7pp Dwg.No.0/0)
- PN JP2268995 A 19901102 DW199050 000pp
 - JP7067636B B2 19950726 DW199534 B23K35/363 006pp
- PR JP19890090769 19890412
- PA (ISHF) ISHIFUKU KINZOKU KOGYO KK
- MC A04-G04 A04-G05 A12-W12F M23-A
- DC A18 A97 M23 P55
- IC B23K35/36 ;B23K35/363
- AN 1990-372169 [34]

PAJ ======

- TI BINDER FOR SOLDER PASTE
- AB PURPOSE: To facilitate handling and to prevent carbon residues from remaining at the time of using the binder in the atm., neutral atmosphere or reducing atmosphere by specifying the ratios of specific components and the ratios of a solvent.
 - CONSTITUTION: The binder for the solder paste of a nonaq. system consists of (A) 3 to 96wt.% at least one kind of polyisobutyrene and polybutene, (B) 4 to 40wt.% at least one kind of methane hydrocarbon and fatty acid having >=30 deg.C m.p. (C) 0 to 94wt.% at least one kind of solvent of aliphat. hydrocarbon and arom. hydrocarbon having <=0 deg.C m.p. The corrosion of the solder powder is obviated and the chemical stability is maintained in this way even after long-term preservation. Workability is good and the brazing strength is satisfied.
- PN JP2268995 A 19901102
- PD 1990-11-02
- ABD 19910121
- ABV 015025
- AP JP19890090769 19890412
- GR M1071
- PA ISHIFUKU KINZOKU KOGYO KK
- IN SASAKI KOKI; others: 02
- I B23K35/363

19 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平2-268995

⑤Int. Gl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)11月2日

B 23 K 35/363

E 7728-4E

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全7頁)

図発明の名称 ろ・

ろうペースト用バインダー

②特 顧 平1-90769

良

②出 願 平1(1989)4月12日

@発明者 佐々木 幸記

埼玉県草加市青柳町1080番地 石福金属興業株式会社草加

第一工場内

⑩発明者朝木 知美

埼玉県草加市青柳町1080番地 石福金属興業株式会社草加

第一工場内

砲発 明 者 南 正

埼玉県草加市青柳町1080番地 石福金属興業株式会社草加

第一工場内

⑪出 願 人 石福金属興業株式会社

東京都千代田区内神田 3 丁目20番 7 号

四代 理 人 弁理士 富田 幸春

明細書

1. 発明の名称

ろうペースト用バインダー

- 2. 特許請求の範囲
- (1)(A) ポリイソプチレン及びポリプテンの少なくとも1種が3~96wt%、
- (8) 融点が30℃以上であるメタン列炭化水素及び 脂肪酸の少なくとも1種が4~40wt%、
- (C) 融点がOで以下である脂肪族炭化水素及び芳香族炭化水素の少なくとも1種の溶剤がO~94wt %

とからなることを特徴とする非水系のろうペース ト用パインダー。

- (2) ろうペーストがろう粉末とバインダーから 成り、中性雰囲気、返元性雰囲気中でろう付けさ れることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載 のろうペースト用バインダー。
- (3) ろうペーストがろう粉末及びフラックスと バインダーとから成り、大気中でろう付けされる ことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のろ

うペースト用バインダー。

- (4) ろう粉末の融点が500 ℃以上であることを 特徴とする特許請求の範囲第2項および第3項い ずれか記載のろうペースト用バインダー。
- 3. 発明の詳細な説明

〈産業上の利用分野〉

開示技術は大気中や、中性雰囲気中、或いは、 還元性雰囲気中でろう付けをするときに使用され るろうペーストのバインダーに係る技術分野に属 する。

〈従来技術〉

当業者に周知の如く、金属等の接合等に用いるろう付けの合理化のため、ろう粉末とパインダー、及び、必要に応じてフラックスを混合し、ペースト状とした所謂ろうペーストが採用されつつある。

而して、該種ろうペーストに使用されるろう粉末は、公知のろう材粉末、例えば、Au ろう粉末、Ag Pd ろう粉末、Pd ろう粉末、Ni ろう粉末、Cu ろう粉末等が使用可能である。

ところで、パインダーに要求される条件として

次に、ろう粉末とフラックスとをバインダーと 混合してペースト状となし、6か月の長期保管を 行なうと、ろう粉末を腐蝕してしまう虞があるた め、バインダー組成はろう粉末に対して化学的に 安定で、且つ、非水系バインダー組成であること

る条件を満足する物ではない難点があった。

更に、ポリイソプチレン、及び、ポリプテンに ゲル化剤を添加したバインダーもあるが、N₂雰 囲気中、又は、大気中の使用では残渣が残り、1 ~3か月の保管期間でろう粉末とバインダーが分 難する難点があった。

〈発明の目的〉

この出願の発明の目的は上述従来技術に基づく ペースト使用のバインダーの問題点を解決すべき 技術的課題とし、バインダーに要求される条件、 及び、バインダーの組成に要求される条件を可及 的に全て充分に満足し得るようにして金属製品製 造産業における接合技術利用分野に益する優れた ろうペースト用バインダーを提供せんとするもの である。

〈発明の技術的背景〉

次に、この出願の発明の背景について述べると、 発明者らはポリイソプチレンとポリプテンは大気 中、中性雰囲気中、或いは、還元性雰囲気中で加 熱した際、カーボン残渣がなく、又、これらは広 が望ましいことである。

而して、在来のろうペーストに使用されるバインダーとしては、例えば、特公昭57-50598号公報発明の銅ペースト組成物としてポリアルキレングリコウル、又は、ポリアルキレングリコウル誘導体と水とからなるバインダーが示されている。

又、特公昭63-43200号公報発明のアルミペースト相成物には脂肪族炭化水素重合体が記載されており、ポリイソプチレン、及び、ポリプテンは該脂肪族炭化水素重合体に含まれはする。

〈発明が解決しようとする課題〉

しかしながら、上述公報の前者のバインダーは 大気中でろう付けを行なった場合、カーボン残渣 が残り、又、保管中にろう粉末が腐蝕する欠点が あり、満足出来る物ではなかった。

又、後者の脂肪族炭化水素重合体に含まれ得るポリイソプチレン、及び、ポリプテンを液体パラフィンで溶解混合しバインダーとなし、ろう粉末と混合してろうペーストとした物は保管中にろう粉末と分離し、上述の如きバインダーに要求され

範囲の分子量を選択することが出来ることを見出 した。

しかしながら、ポリインとポリスペーストロールでは以上を必要に応合する軟らかさ、の1種以インダーに適合する軟らかさ、ろうのでは流動性を示した。これでは流動性をとき、高分子のようがなない。なが、スカーの表別を表別ではあり、ないないでは、ないが、ないができない。ないが、1~6か月の長期保管ではろう物末を分離することが分った。

而して、発明者らにおいては上述発見に基づき パインダーの流動性を抑える手段を種々検討した 結果、ポリイソプチレンとポリプテンの1種以上 を必要に応じ溶剤にて溶解したものに、溶解し、 ろう付け時にカーボン残渣を残さず、室温で固体 である物質を添加することにより、ろう粉末の分 餓を抑制することが可能であることをも見出した のである。

〈課題を解決するための手段・作用〉

上述目的に沿い先述特許請求の範囲を要旨とするこの出願の発明の構成は前述課題を解決するために、(A) ポリイソプチレン、及び、ポリプテンの少なくとも1種が3~96wt%で、

(8) 融点が30で以上であるメタン列炭化水素、及び、脂肪酸の少なくとも1種が4~40wt%であり、(C) 融点が0℃以下である脂肪族炭化水素、及び、芳香族炭化水素の少なくとも1種の溶剤が0~94wt%である組み合わせからなし、使用されるカースト用バインダーであるようにし、使用されるの分・ストリプチレン、及び、ポリプテンは広範囲の分子量を選択することが可能であり、ポリプテンは平均分子量が200~4、000に亘る範囲の各グレードを選択することが可能である。

而して、ポリイソプチレン、及び、ポリプテン の少なくとも1種を必要に応じ溶剤にて粘度調整

て粘度調整し、更に触点が30℃以上であるメタン 列炭化水素、及び、脂肪酸の少なくとも1種を混 合溶解したバインダーであり、6か月間の長期に 直りろう粉末、及び、フラックスを分離せず、大 気中、中性雰囲気中、逗元性雰囲気中でろう付け した際カーボン残渣を残さずに燃焼、又は、分解、 揮発するようにした技術的手段を講じたものであ る。

〈発明の構成の限定理由〉

而して前述特許請求の範囲の構成要件の限定理由について詳説すると、ポリイソプチレンとポリプテンの少なくとも1種の割合を3~96wt%とした理由は各種実験の結果、3wt%未満ではろう粉末と混合してろうペーストとする際、被ろう付け部分への付着性、及び、ろう付け時の付着性が悪く、充分なろう付けが出来ないためであり、一方、96wt%を越えると、保管中にろう粉末と分離し、パインダーとして不適当であることが分ったからであり、又、実用上好ましくは5~94wt%である。

そして、融点が30℃以上であるメタン列炭化水

を行ない、EHD型粘度計(東京計器株式会社製)にて20℃、5грm で10~90(ローター1°34で測定した値)の読みに大体対応する1,000~9,000センチポイズ、及び、20℃、5гpm で0.5~12.5(HH 型ローターNO-4で測定した値)の読みに大体対応する8,000~200,000センチポイズの範囲の粘度に調整し、次に融点が30℃以上であるメタン列炭化水素及び脂肪酸の少なくとも1種を加え、機拌しながら90±10℃で加熱溶解し、その後常温まで冷却する。

而して、ろうペーストに使用されるバインダーの粘度はろうペーストを構成するろう粉末とフラックスの比率によって異なり、ろう粉末とバインダーを混合し、ろうペーストとなす時の粘度は20,000~300,000 センチポイズであって、ろう粉末とフラックスとバインダーとの三者を混合し、ろうペーストと成す時の粘度は1,500~100,000 センチポイズである。

而して、バインダーはポリイソプチレン、及び、 ポリプテンの少なくとも1種を必要に応じ溶剤に

素、及び、脂肪酸の少なくとも1種の割合を4~40wt%とした理由はこれまた実験を重ねた結果、4wt%未満ではバインダーの流動性を抑えることが出来ない為、ろう粉末と混合してペーストにした際、保管中に分離してしまうことが知られたためであり、40wt%を越えると固化してしまうため、バインダーとして不適当であることが分り、そして、実用上好ましくは5~36wt%であることが分った。

次に、融点がOで以下である脂肪族炭化水素と 芳香族炭化水素の少なくとも一種の割合をO~94 wt%とした理由は同様実験により確認されたもの で、下限をOwt%とした理由は低分子量のポリプ テンを選択することにより溶剤を加えなくとも、 パインダーとして満足するためである。

一方、94wt%を越えると、ろう粉末と混合してペーストにした際、被ろう付け部分への付着性、及び、ろう付け時の付着性が悪く、又、保管中に分徴してしまうことが分ったためである。

そして、その範囲は好ましくは0~90wt%であ

る。

(実施例)

次に、この発明の実施例を説明すれば以下の通 りである。

(実施例1)

ポリイソプチレン、及び、ポリプテンの少なくとも1種をキシレンにて溶解した後、これに融点が約70℃であるメタン列炭化水素の混合体(以下メタン列炭化水素の混合体をメタン列炭化水素と略称)と、ステアリン酸の少なくとも1種を混合して、慢拌しながら90±10℃で2時間加熱溶解し、その後常温まで冷却してろうペースト用バインダー(後述表-1の実施例1~1~実施例1~5)を作製した。

次に、比較例として本特許の請求範囲外の組成 について同方法によりバインダー(同様表 - 1の 比較例 1 - 1~比較例 1 - 5)を作製した。

各成分の組成は表ー1の通りである。

かようにして作製した各パインダー10g に72% Ag Cu ろう粉末90g を混合し慢拌してろうペー

パラフィンである n ー オクタン、イソパラフィンであるイソーオクタン、イソパラフィンと少量の n ー パラフィンを含む I S O P A R (エクソン化学株式会社製)、n ー パラフィンとイソパラフィンの混合体)にて溶解し、更に、融点が70℃であるメタン列炭化水素を加え、上述実施例1と同じ方法にてろうペースト用バインダー(表 ー 2 の実施例2 − 1~実施例2 − 4)を作製した。

次に、比較例として常温で液体である流動パラフィンを加え、混合機拌してろうペースト用バインダー(同じく表ー2の比較例2-1~比較例2-5)を作製した。

各成分の組成は当該表一2の通りである。

こうして作製した各バインダー10g に72% Ag Cu ろう粉末90g を混合假拌してろうペースト 9 種を作製した。

この各ろうペーストのろう粉末とパインダーの 分盤状況を実施例1と同方法にて確認した。

結果は表-2の通りである。

(実施例3)

スト10種を作製した。

作製したろうペーストの混合状態は後述表 - 1 の通りである。

次に、各ろうペースト100gをガラス容器に入れ、 温度25±1℃の恒温機にてろう粉末とバインダー の分錐状況を確認した。

結果は表-1の通りである。

該表 − 1 中の項目の◎印は6か月間保管で分離が認められなかったもので、○印は3~6か月の間に分離が認められたもの、△印は1~3か月の間に分離が認められたもの、×印は1か月以内に分盤が認められたものを意味するものである。

更に、これらのろうペーストを鉄母材(7号試験片)に塗布しN2雰囲気中、H2雰囲気中840 でで重ねろう付けを行ない、カーボン残渣を確認した

これらの結果は表-1に示す通りである。

(実施例2)

ポリイソプチレン、及び、ポリプテンの少なく とも1種を液体パラフィンの溶剤(例えば、n-

ポリイソプチレン、及び、ポリプテンの少なくとも1種をキシレンにて溶解し、融点が70℃であるメタン列炭化水素及び、ラウリン酸、ミリスチン酸、ステアリン酸の少なくとも1種を加え、実施例1と同じ方法にてろうペースト用バインダー(後述表-3の実施例3-1~実施例3-4)を作製した。

次に、比較例としてポリイソプチレン、及び、ポリプテンの少なくとも1種をキシレンにて溶解した後、有機ゲル化剤としてゲルホウルD(新日本理化株式会社製)を加え充分慣拌した後、恒温機にて80±1℃で1時間加熱し、その後常温まで冷却してろうペースト用バインダー(同じく表ー3の比較例3-1)を作製した。

次に、比較例として有機ゲル化剤としてボルチセットペーストリス(ヘキストジャパン株式会社製)を高速攪拌しながら加えた後、恒温機にて45±1℃で2時間加熱し、その後常温まで冷却してろうペースト用バインダー(比較例3-2)を作製した。

更に比較例として有機ゲル化剤としてボルチゲルチクソA(ヘキストジャパン株式会社製)を高速投拌しながら加えた後、恒温機にて45±1℃で48時間加熱し、その後常温まで冷却してろうペースト用パインダー(同表ー3比較例3-3)を作製した。

各成分の組成は表一3の通りである。

こうして作製した各バインダー10g に72% Ag Cu ろう粉末90g を混合擬拌してろうペースト 7 種を作製した。

この各ろうペーストのろう粉末とバインダーの 分離(A)状況を実施例1と同じ方法にて確認し た。

結果は当該表-3の通りである。

更に、このろうペーストを鉄片母材に塗布し、 Nz 雰囲気中、Hz 雰囲気中840 でで重ねろう付けを行ないカーボン残渣の有無を確認した。

結果は表-3の通りである。

次に、各バインダー12g にBAg - 7 Ag ろう 粉末65g とAg ろう用フラックス23g とを混合機

種にて溶解した後、触点が、約50℃、約60℃、約 80℃、約90℃であるメタン列炭化水素、及び、ラ ウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステア リン酸、ソルピン酸、ステアロール酸の少なくと も1種を加え、それぞれ特許請求の範囲内の相成 にて、実施例1と同じ方法にてろうペースト用バ インダーを作製した。

作製した各バインダー10g にJISBAuー4 Au ろう粉末、JISBPdー6Pd ろう粉末、 JISBNiー4Niろう粉末、Cuろう粉末等 の1種90g を混合攪拌してろうペーストを作製し た。

而して、このろうペーストについて、ろう粉末の分離、カーボン残渣、ろうペーストの被ろう付け母材への付着性、ろう付け強度、加熱時にバインダーがはねたために生ずるろう付け後のろう材の飛散熔融等について試験、確認した結果、いずれも良好な結果が得られた。

〈発明の効果〉

以上、この発明によれば、先述特許請求の範囲

拌してろうペーストとなした。

この各ろうペーストのろう粉末、及び、フラックスとバインダーの分離(B)状況を実施例1と同じ方法にて確認した。

結果は同じく表-3の通りである。

更に、このろうペーストを鉄母材(7号試験片) に塗布し、大気中トウチバーナーで重ねろう付け を行ないろう付け強度を確認した。

結果は表-3の通りである。

該表一3に於てもろう付け強度は強度が30kg/mm²以上を〇印、30kg/mm²未満を×印として表示した。

(実施例4)

ポリイソプチレン、及び、ポリプテンの少なくとも1種をローヘキサン、ローヘプタン、ローペンタン、イソヘキサン、イソペンタン、イソヘキサン、シクロペンタン、ISOSOL(日本石油化学株式会社製)、日石ソルペント(日本石油株式会社製)ペンセン、トルエン、ソルペントナフタ、石油ペンジンの少なくとも1

の限にはいか。 の限にはいかしたことにより、金属に対する大気ではいか。 の限定を行ないがしたのでは、辺元性がいかのでは、辺元性がいかのでは、辺元性がいかのであり、であり、辺にないができるようでは、でいるのでは、でいるのでは、でいるのでは、でいるのでは、でいるのでは、でいるのでは、のではないが、切れがいるのである。 というでは、切れがいるのである。 をはいかのである。 をはいかのである。

そして、先述特許請求の範囲の組成にしたことにより、ろう付け時に燃焼に際して分子鎖が分解して完全に揮発する効果があり、6か月等の長期保管を行なっても、ろう粉末が腐蝕せず、化学的に安定し、安定した組成とすることが出来、作業性が良好で、ろう付強度を満足するろう付け用バインダーが得られるという優れた効果が奏される。

表-1

			バインダーの成分組成			試験	桔果
•	_ ポリマ	-	メタン列 次化水素 および脂肪酸	语刷	分離	カーボン残渣	混合状態
実施例 1-1	ポリプテン	; 94wt%	メタンレツタンカスイソ: 6wt%	-	0	無	ペースト状
実施例 1-2	ポリイソプチレン	; 5wt %	ステアリン酸 : 25wt%	キシレン:70wt%	0	無	ペースト状
実施例 1-3	ポリイソプチレン	; 10wt%	メタンレツタンカスイソ;10wt%	キシレン:80wt%	0	無	ペースト状
実施例 1-4	ポリイソプチレン+ ポリプテン	; 40wt%	メタンレツタンカスイソ:15wt%	キシレン:45wt%	0	無	ペースト状
実施例 1-5	ポリイソプチレン+ ポリプテン	: 80wt%	メタンレツタンカスイソ+ ステアリン酸 ; 20wt%		0	M	ペースト状
比较例 1-1	ポリプテン:	100wt%	-	-	×	無	ペースト状
比較例 1-2	ポリプテン	; 98wt%	メタンレツタンカスイン; 2wt%	-	×	無	ペースト状
比較例 1-3	ポリイソプチレン	: 2wt%	メタンレツタンカスイン;10wt%	キシレン:88wt%	×	無	ペースト状
比较例 1-4	ポリイソプチレン	; 10wt%	ステアリン酸 : 70wt%	キシレン:20wt%	0	無	固化
比較例 1-5	ポリイソプチレン+ ポリプテン	; 40wt%	ステアリン酸 : 45wt%	キシレン ; 15wt%	0	無	固化

表-2

	バインダーの成分組成						
	ポリマー	メタン列炭化水素 および脂肪酸	溶剤	分離			
実施例 2-1	ポリイソプチレン:10wt%	メタンレツタンカスイソ:10wt%	n-オクタン :80wt%	0			
実施例 2-2	ポリイソプチレン;10wt%	メタンレツタンカスイソ:10wt%	イソーオクタン:80wt%	0			
実施例 2-3	ポリイソプチレン:10wt%	メタンレツタンカスイソ;10wt%	ISOPAR :80wt%	0			
実施例 2-4	ポリイソプチレン+ ポリブテン : 30wt%	メタンレツタンカスイソ;15wt%	∩−オクタン+ イソ−オクタン;55wt%	0			
比較例 2-1	ポリイソプチレン:10wt%	流動パラフィン ; 10wt%	ローオクタン :80wt%	×-			
比較例 2-2	ポリイソプチレン:10wt%	流動パラフィン ; 20wt%	イソーオクタン:70wt%	×			
比較例 2-3	ポリイソプチレン:10wt%	流動パラフィン ; 20wt%	ISOPAR :70wt%	×			
比较例 2-4	ポリイソプチレン+ ポリプテン ;30wt%	流動パラフィン : 50wt%	nーオクタン+ イソーオクタン:20wt%	×			
比较例 2-5	ポリイソプチレン+ ポリプテン ; 30wt%	流動パラフィン ; 70wt%	-	×			

特開平2-268995 (フ)

表一3

	バインダーの成分組成			試験枯果							
	ポリマー		メタン列炭化水素 および脂肪酸	溶剤	分離		カーボン残渣			73444	
			有機ゲル化剤		(E) NY	(A)	(8)	Nz	Hz	大気中	ろう付け性
実施例 3-1	ポリプテン	; 60wt%	メタンレツタンカスイソ	; 15wt%	キシレン:25wt%	0	0	無	無	無	0
实施例 3-2	ポリイソプチレン	; 35wt%	ラウリン酸	; 35wt%	キシレン;30wt%	0	0	無	無	無	0
実施例 3-3	ポリイソプチレン+ ポリプテン	; 30wt%	ミリスチン酸	; 35wt%	キシレン;35wt%	0	0	無	無	無	0
実施例 3-4	ポリイソプチレン+ ポリプテン	; 80wt%	ステアリン酸	; 20wt%		0	0	無	無	無	0
比较例 3-1	ポリプテン	; 60wt%	ゲルオールD	: 0.5wt %	キシレン; 39.5wt%	×	Δ	有	無	有	×
比较例 3-2	ポリイソプチレン	; 35wt%	ポルチセット ペーストUZ	; 2.0wt %	キシレン:63.0wt%	Δ	Δ	有	無	有	×
比较例 3-3	ポリイソプチレン+ ポリプテン	: 80wt%	ボルチゲル チクソ A	; 1.0wt %	キシレン;19.0wt%	Ą	Δ	有	無	有	×